

金融护航新型工业化，集成电路成政策重点

原创 来觅研究院 RimeData 来觅数据

撰稿 李沛瑶 2025-08-11



导读：8月5日，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，标志着国家层面对新型工业化战略的金融支持进入实质落地阶段。在所有提及的产业链中，集成电路排名最前，充分显示了产业的重要程度。目前，集成电路产业现状如何？为何政策高度关注？产业还有哪些未突破的重点领域？投融资情况如何？本文尝试分析和探讨。

政策加码新型工业化

2024年10月，工业和信息化部在国务院新闻办发布会上明确表态，将加速制定出台《关于金融支持新型工业化的指导意见》。2025年8月，该政策正式出台，标志着国家层面对新型工业化战略的金融支持进入实质落地阶段。该政策的酝酿与出台，正值中国经济面临内外多重挑战的关键时期。一方面，全球产业链重构进程加快，高端制造与核心技术自主可控上升为国家战略核心；另一方面，国内经济转型压力凸显，传统制造业面临产能过剩、效率低下等结构性难题，而新兴产业尚处培育期，亟需金融资源的精准支持。在此背景下，政策文件的发布既是对“十四五”规划新型工业化战略的深化落实，更是对当前经济运行中结构性矛盾的精准施策。

图表 1：《关于金融支持新型工业化的指导意见》正式出台

中国人民银行

THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

信息公开

服务互动

新闻发布

金融科技

法律法规

人民币

货币政策

经理国库

宏观审慎

国际交往

信贷政策

人员招录

金融市场

学术交流

金融稳定

征信管理

调查统计

反洗钱

银行会计

党建工作

支付体系

政务公开

政策解读

公告信息

图文直播

央行研究

音频视频

市场动态

网上展厅

报告下载

报刊年鉴

网送文告

办事大厅

在线申报

下载中心

网上调查

意见征集

金融知识

关于我们

2025年8月11日 星期一 | 我的位置: 首页 > 沟通交流 > 新闻

中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》

字号 大 中 小

文章来源: 沟通交流

2025-08-05 16:00:00

打印本页 关闭窗口

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实全国新型工业化推进大会部署，加快金融强国和制造强国建设，近日，中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨和防范化解金融风险的根本举措，聚焦新型工业化重大战略任务，以需求牵引深化金融供给侧结构性改革，强化产业政策和金融政策协同，为推进新型工业化、加快发展新质生产力提供高质量金融服务，坚持分类施策、有扶有控，推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟，服务适配性有效增强。

《意见》对照新型工业化重点领域，提出针对性支持举措。优化金融政策工具支持关键技术产品和攻关，多渠道为科技成果转化引入耐心资本，强化产业链重点企业综合金融服务，提升产业科技创新能力和产业链供应链韧性。发展科技金融、绿色金融、数字金融等五篇大文章，深化基于“数据信用”和“物的信用”的产业链金融服务模式，支持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业。健全中西部承接产业转移有关授信管理机制和金融产品服务，推动金融资源向产业集群聚集和专业化发展，推进贸易结算、资金管理、投融资等一系列跨境金融服务便利化举措，支持产业合理布局 and 拓展发展空间，促进做强国内大循环。

《意见》加强金融服务能力和长效机制建设，促进保持制造业合理比重投入。健全金融机构服务制造业的内部机制安排，单列制造业信贷计划，针对细分行业和企业成长阶段特点制定差异化授信政策。双向培养科技产业金融复合型人才队伍，鼓励金融机构打造复合型的金融管理和服务团队。建立完善跨部门协同推进、政策激励约束、地方政策配套、风险协同防控等4方面机制，发挥结构性货币政策和宏观信贷政策引导作用，增强金融支持新型工业化的强度精度效度。

资料来源：中国人民银行、来觅数据

新型工业化战略在"十四五"规划中的定位经历了从概念提出到具体实施的演进过程。2021 年"十四五"规划纲要首次明确提出"推进新型工业化"，将其作为高质量发展的重要路径。随着新一代信息技术快速发展，新型工业化内涵不断丰富，逐步涵盖智能制造、绿色制造等多维度。当前中国经济正处于由高速增长向高质量发展的关键转型期，金融支持政策的重要性日益凸显。一方面，传统制造业面临产能过剩、盈利承压等挑战，亟需通过技术升级重塑竞争力；另一方面，新兴产业虽成长性突出，但受技术门槛高、研发周期长等因素制约，融资难度较大。在此背景下，金融政策的精准施策尤为重要。2025 年上半年，中央财政持续加码普惠金融支持，通过设立示范区、提供贴息等方式缓解小微企业融资难题。数据显示，2025 年 5 月制造业固定资产投资同比增长 7.5%，装备制造业增长 6.3%，民间投资增长 6.7%，反映市场信心

逐步修复。同时，央行通过降准等货币政策工具释放流动性，5月社融新增2.29万亿元，政府债成为主要支撑。政策协同发力有效降低融资成本，提升资金使用效率。

近年来，我国金融支持政策在新型工业化战略框架下呈现出显著的延续性与系统性特征。2021-2024年间，工业和信息化部持续推进产融合作，逐步构建起涵盖重点产业链、科技创新、绿色转型及中小微企业的多层次金融支持体系。2024年10月，工信部明确提出将加快出台金融支持新型工业化的专项政策，标志着政策实施进入关键阶段。这种政策延续性不仅体现在战略目标的一致性上，更反映在具体措施持续优化中。以国家产融合作平台为例，该平台已整合超过3100家金融机构，推出800余款金融产品，累计实现企业融资规模逾1.2万亿元，充分彰显政策执行的高效协同效应。同时，政策工具箱持续丰富，“创新积分贷”、科技型企业上市培育库等创新工具为集成电路等“硬科技”领域提供了精准支持。政策的连贯性有效增强了市场预期稳定性，助力企业优化长期研发投入与产能扩张规划，从而提升行业整体抗风险能力与创新水平。

图表 2：2021 年来我国新型工业化部分相关政策

发布日期	发布单位	政策名称	主要内容
2025 年 8 月	工信部等四部门	《机械工业数字化转型实施方案(2025—2030 年)》	坚持创新发展、安全可控，坚持场景牵引、问题导向，研制一批智能装备、建设一批智能工厂、拓展一批智慧服务，推动机械工业高端化、智能化、绿色化发展，为推进新型工业化提供坚实的技术装备保障
2025 年 8 月	中国人民银行等七部门	《关于金融支持新型工业化的指导意见》	优化金融政策工具支持关键技术产品和攻关，多渠道为科技成果转化引入耐心资本，强化产业链重点企业综合金融服务，提升产业科技创新能力和产业链供应链韧性
2025 年 1 月	工信部等三部门	《制造业企业数字化转型实施指南》	要加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，加速产业模式和企业组织形态变革，系统提升企业数字化水平，不断培育新质生产力发展新动能，促进实体经济和数字经济深度融合，加快推进新型工业化
2024 年 4 月	工信部等三部门	《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》	推动更多金融资源用于促进先进制造，实现我国从制造大国向制造强国转变，引导金融机构以服务制造业高质量发展为主题，深化金融服务，助力推进新型工业化
2024 年 1 月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	发展适应通用智能趋势的工业终端产品，支撑工业生产提质增效，赋能新型工业化。发展量大面广、智能便捷、沉浸体验的消费级终端，满足数字生活、数字文化、公共服务等新需求
2023 年 7 月	工信部等五部门	《制造业可靠性提升实施意见》	加快构建新发展格局，统筹发展和安全，落实制造强国、质量强国建设要求，全面推进新型工业化，提升产业链供应链韧性和安全水平，强化可靠性技术攻关，发挥标准的引领作用，推动数字化智能化赋能
2023 年 3 月	国务院	《加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济》	要通过锻长板、补短板、强基础，加快建设现代化产业体系。具体而言，要改造提升传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业
2021 年 11 月	工信部	《“十四五” 信息化和工业化深度融合发展规划》	党的十九届五中全会提出 2035 年基本实现社会主义现代化的远景目标，并将“基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”（新四化）作为重要发展目标。“十四五”时期亟需通过两化深度

			融合，推动产业数字化和数字产业化，加快质量变革、效率变革和动力变革，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，为实现“新四化”提供有力支撑
2021 年 10 月	工信部等八部门	《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023 年)》	推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

资料来源：来觅数据

《关于金融支持新型工业化的指导意见》的出台，旨在有效解决当前我国制造业面临的融资期限错配问题，促进产业资本与金融资源的高效协同。近年来，随着新型工业化战略的深入推进，制造业企业普遍面临长期资金需求与短期融资供给之间的结构性矛盾。中国人民银行数据显示，截至 2025 年第一季度，制造业中长期贷款余额同比增速达 9.3%，但仍低于整体信贷增速，表明金融机构在资源配置上仍存在短期化倾向。指导意见通过引导金融机构优化信贷结构、创新融资工具，鼓励建立与制造业周期相匹配的中长期融资机制，有助于缓解企业因期限错配导致的资金压力。集成电路在《关于金融支持新型工业化的指导意见》所提及的重点产业链中排名第一，其项目投资周期长、回报周期慢，传统短期融资方式难以满足其持续研发和产能扩张需求。指导意见提出构建“融资期限与产业周期相协调”机制，将为这类企业提供更稳定的资金保障，增强其风险抵御能力和可持续发展韧性。

集成电路发展现状

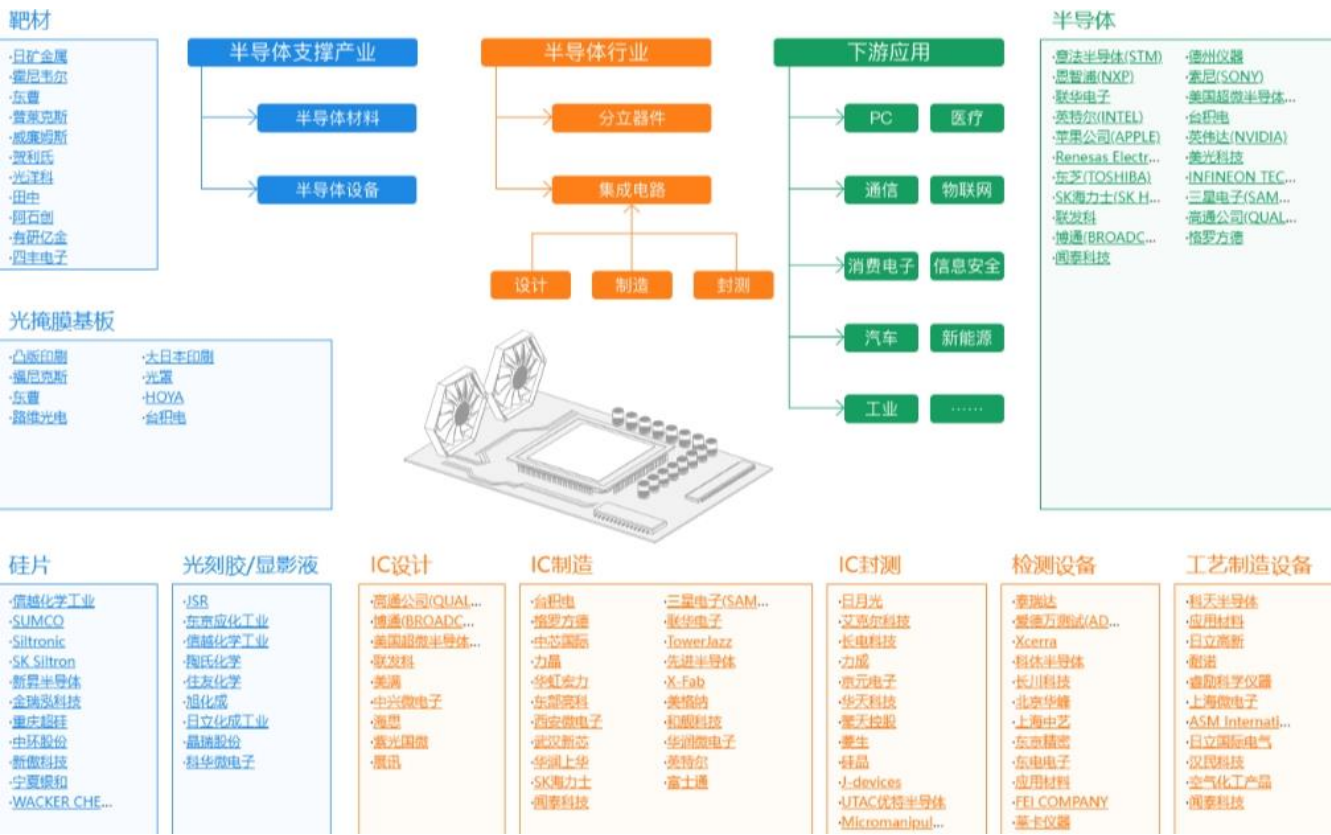
集成电路是指通过特定的半导体制造工艺，将大量的晶体管、电阻、电容等电子元器件以及它们之间的互连线，集成制作在一块微小的半导体晶片上，形成一个具备特定电路功能的微型电子器件或系统。集成电路在日常使用中经常会与半导体、芯片等词混用。集成电路是信息技术产业的核心，按功能分为逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片等，广泛应用于消费电子、汽车电子、人工智能等领域。2024 年，全球半导体市场规模达 6202 亿美元，中国占 30.1%，但美国企业仍占据 50% 的市场份额。国内企业在 5G 通信芯片、AI 芯片等领域取得突破，但整体市场份额不足 20%。值得注意的是，2025 年中国 AI 芯片国产化率预计突破 40%，寒武纪等企业受益于政策推动的国产替代需求。

依照集成电路行业的上下游，可以将集成电路分为上游的芯片设计，中游的半导体设备、半导体材料及集成电路制造，以及下游的集成电路封装及测试环节。2025 年上半年，受多重利好因素驱动，国内半导体材料设备市场呈现强劲增长态势。海外关税政策收紧倒逼国内晶圆厂加速国产材料设备验证进程，显著提升本土供应链安全等级。

在 8 月 8 日召开的中芯国际二季度业绩说明会上，公司 CEO 赵海军表示，从目前最新的订单状况来看，预计至少到今年 10 月份左右，中芯国际产能依然维持供不应求，表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到 8、9 月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，但中芯国际对订单获取有很大信心。集成电路制造是半导体行业的核心环节，晶圆厂的稼动率通常预示着行业景气度的高低。在过去几年，由于芯片本地化的需求以及技术突破，中芯国际的市场份额持续提升，目前已成为全球第三大晶圆代工厂，与三星电子规模相当。

在下游的集成电路封装和测试环节，国内企业通过并购实现跨越式发展。目前长电科技、通富微电全球竞争力显著提升，已成为全球第三、第四大封测厂商。但在先进封装领域仍存在技术短板，整体水平落后国际领先企业 2-6 年。随着 AI、HPC 等高端芯片需求的快速增长，国内封测企业正在加大先进封装技术的研发投入，力求突破技术瓶颈。未来，国内封测行业有望在政策支持和市场需求的双重驱动下，实现技术升级和国产替代。

图表 3：集成电路全景图



资料来源：Wind、来觅数据整理

发展集成电路，具备巨大的现实意义。在全球科技革命与产业变革持续深化的背景下，中国将科技创新与产业升级的协同发展作为推动高质量发展的核心驱动力。而科技创新的根基，正是集成电路。改革开放四请务必阅读正文之后的免责声明

十年以来，中国的电子工业取得了巨大的成果，然而“缺芯少屏”一直是电子工业的隐忧。2018 年美国启动对我国的贸易战，使得解决“卡脖子”问题成为产业升级的重中之重，而《关于金融支持新型工业化的指导意见》的出台，正是要通过多元化金融工具组合精准赋能集成电路，显著提升产业链现代化水平。

早在 2014 年，我国就启动了国家集成电路产业投资基金，十年以来累计投入超过 6800 亿，加上如深创投、元禾控股、合肥创投、长江产投等地方产投基金，中科创星、同创伟业等民间资本，累积投资超万亿。在这种背景下，国内集成电路迎来了飞跃式发展，以半导体设备公司北方华创来举例，其自 2017 年以来营业收入涨幅超 10 倍，净利润上涨超 50 倍。这充分证明了，金融对产业的支持已形成显著的成功范式。而后续的政策持续出台，正是引导资金持续投入产业突破的必要手段。

不过，经过十年的发展，解决卡脖子问题已初见成效，而后期的攻坚战更需要拿出啃硬骨头的精神。目前国内集成电路仍存在着“三座大山”，仍需国家拿出集中力量办大事的精神，联合资本和产业共同突破，以期达到解决产业困境，突破国际先进水平。

其一是先进半导体设备与海外仍存在差距。目前主流晶圆代工厂如台积电、三星电子、英特尔、SK 海力士均采用了 ASML 的 EUV 光刻设备，而我国受制于瓦森纳协定，至今仍没有可使用的 EUV 设备，依赖 DUV 多重曝光技术实现先进制程。事实上，不仅光刻机研发相对滞后，涂胶显影机、先进量测设备、离子注入机等前道设备也严重依赖海外半导体设备厂商。

其二是先进制程与海外存在明显代际差。先进制程是现代制造业的皇冠，融合最先进的物理学与化学技术。目前旗舰手机、人工智能、自动驾驶、机器人等下游应用均需要先进制程提供制造能力。而我国国产 14nm 工艺良率达 95%，但 N+3 工艺仍处于风险量产阶段，而国际头部企业已实现 3nm 量产并推进 2nm 研发。总体而言，我国晶圆代工与海外仍存在两个代际以上的差距。

其三是上游工具自主可控率低。EDA 工具和 IP 核是芯片设计的上游，被美系厂商占据绝大部分市场。目前全球近 80% 的 EDA 市场被美国三大厂商垄断，国产 EDA 工具市占率仅 10% 左右。国内 EDA 企业与晶圆厂、设计公司协同不足，缺乏工艺库和 IP 核积累，导致工具与实际生产流程适配性相对较差，这一点更需要培育国产使用生态体系，全链条实现国产替代的突破。

展望

来觅数据显示，2025 年上半年半导体领域共发生 395 起融资事件，总融资金额 275.53 亿元，同比均实现增长。半导体产业投融资热度持续升温，在政策引导与市场需求双轮驱动下，资本市场对这一战略性新兴产业的关注度显著提升。这一趋势既反映出投资者对国产替代与技术自主可控的坚定信心，也体现了国家在新型工业化背景下对关键核心技术扶持力度的持续加码。

科创板作为科技创新重要支撑平台，近年来在半导体领域的 IPO 募资效率与产业带动效应日益凸显。截至 2025 年 6 月，科创板累计受理未盈利半导体企业 IPO 数量达 11 家，包括上海超硅、摩尔线程等标杆企业。这些企业普遍聚焦高技术门槛、高附加值细分领域，如 300mm 硅外延片、GPU 芯片设计等，募资金用途多集中于产能扩充、技术研发及市场开拓。

在政策和资本的持续推动下，半导体产业迎来新一轮资本注入高峰，尤其在关键器件与系统集成领域，政策性资金的介入显著增强了企业抗风险能力与技术攻关动能。这类企业通常位于产业链上游，具有技术壁垒高、研发周期长等特点，国家大基金的定向支持有效缩短其技术转化路径，加速产品商业化进程。此外，大基金的介入还产生显著产业链协同效应，通过资本纽带促进上下游企业联动，推动国产芯片与国产操作系统、硬件平台的深度适配。

下图是 2025 年以来半导体的部分融资事件，可以看到产业单笔融资金额普遍较大，这也代表产业正进入后期的攻坚阶段。感兴趣的读者，可以登录 Rime PEVC 平台获取半导体赛道全量融资案例、被投项目及深度数据分析。

图表 4：2025 年以来集成电路部分投融资事件



资料来源：来觅数据

版权声明： 未经来觅数据许可或授权，任何单位或人士不得转载、引用、刊登、发表、修改或翻译本报告内容。许可或授权下的引用、转载时须注明出处为来觅数据。否则，来觅数据将保留追究其相关法律责任的权利。

免责声明： 本文基于来觅数据认为可信的公开资料或实地调研资料，我们力求上述内容的客观、公正，但对本文中所载的信息、观点及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不负相关法律责任。本文全部内容仅供参考之用，不构成对任何人的投资、商业决策、法律等操作建议。在任何情况下，对由于参考本报告造成的任何，来觅数据不承担任何责任。

关于我们： Rime PEVC 产品是专注于金融创投市场的 SaaS 服务平台，致力于打造一个开放性的全球私募投资生态平台。Rime PEVC 涵盖了创投市场项目企业、投资机构、私募股权基金、基金管理人、GP、LP 行业赛道等丰富的一级市场数据和资讯，支持批量对项目企业和投资机构进行筛选比较、行业深入研究分析、项目企业风险预警、创投市场投融资动向的实时监控等。

Rime PEVC

机构版 SaaS 平台

添加客服 免费试用